FOUP300EX

FOUP (Front Opening Unified Pod)



Applications

- 300mm wafer process carrier

用　途

- 300mm ウエハープロセスキャリア

Features

- Single molded structure minimizing cleaning drying cycle time
- Entire ESD shell
- Excellent seal capability
- Secure roller clamping latch mechanism
- Long life including gasket
- Conforms to SEMI Standard
- Option：Thin wafer solution

特　長

- 一体成形構造によって、洗浄後の乾燥時間を短縮
- ESDシェル
- 卓越したシール性
- 安全なローラーラッチ機構
- ロングライフ
- SEMI規格準拠
- オプション：薄ウエハー対応

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル3階
信越ポリマー株式会社 営業第三部 第一グループ
電話番号 03-5288-8413　FAX番号 03-5288-3113

AQUAPROOF FOUP300EX

FOUP (Front Opening Unified Pod)



Applications

- 300mm wafer process carrier

用　途

- 300mm ウエハープロセスキャリア

Features

- Maintain the low moisture FOUP inside
- Single molded structure minimizing cleaning drying cycle time
- Entire ESD shell and door
- Excellent seal capability
- Long life including gasket
- Conforms to SEMI Standard
- Option:Advanced Diffuser(AD-SAP FOUP)

特　長

- FOUP内を低湿度に保持
- 一体成形構造によって、洗浄後の乾燥時間を短縮
- ESDシェル、ドア
- 卓越したシール性
- ロングライフ
- SEMI規格準拠
- オプション：高速・高均一窒素パージ用パーツ

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル3階
信越ポリマー株式会社 営業第三部 第一グループ
電話番号 03-5288-8413　FAX番号 03-5288-3113

MW300GT

Automated FOSB (Front Opening Shipping Box)



Applications

- 300mm wafer shipper with automated door

用　途

- 自動化対応300mm ウエハー輸送用容器

Features

- Robust structure for perfect seal during transportation
- Manual open / close function
- Single molded Structure minimizing cleaning drying cycle time
- Conforms to SEMI Standard

特　長

- 輸送中のシール性を保つ高剛性構造
- マニュアル開閉機能付き
- 一体成形構造によって、洗浄後の乾燥時間を短縮
- SEMI規格準拠

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル3階
信越ポリマー株式会社 営業第三部 第一グループ
電話番号 03-5288-8413　FAX番号 03-5288-3113

シンエツ ライトフレーム

ウエハーダイシング用樹脂製軽量テープフレーム

Shin-Etsu Lightframe SEMI G87-1108準拠(φ300mm用)

工程間で発生する
導電性異物を排除し、
パッケージの信頼性を
向上させます。

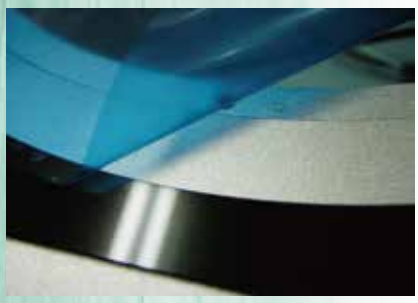


Applications

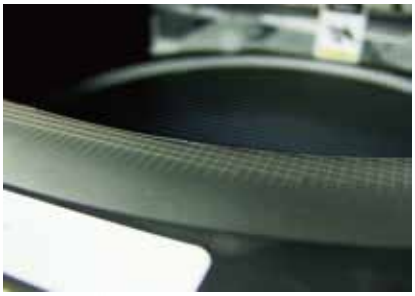
- Wafer dicing process carrier

用　途

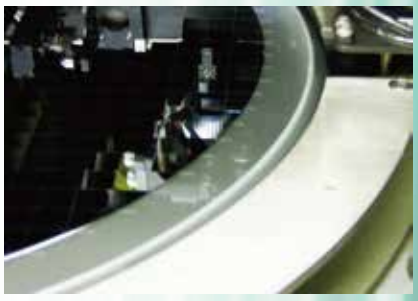
- ウエハーダイシングプロセスキャリア



【Technovision】
Wafer Mounting System
FM-Series (P-cut and normal tape)



【DISCO】
Fully Automatic Dicing Saw
DFD6361



【Shinkawa】
Die Bonder
SPA-300Super

Features

- Reducing Metal particles
- Light weight
- Usability
- Conforms to SEMI Standard

特　長

- 金属異物低減
- 軽量化
- 作業性向上
- SEMI規格準拠（φ300mm用）

品　番	Size	外径 (OD)	内径 (ID)	幅 (W)	厚み (H)	参　考
300NLF-EP	300mm	400mm	350mm	380mm	2.5mm	ラベル対応タイプ
200NLF-EP	8 inch	296mm	250mm	276mm	2.0mm	ラベル対応タイプ
200NLF-FF	8 inch	296mm	250mm	276mm	2.0mm	フルフラットライプ
150NLF-FF	6 inch	228mm	194mm	212mm	1.5mm	フルフラットタイプ

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル3階
信越ポリマー株式会社 営業第三部 第一グループ
電話番号 03-5288-8413　FAX番号 03-5288-3113

シンエツ キャリアテープ
Shin-Etsu Carrier Tape

高機能デバイス用小型チップを梱包可能
Available for taping high-performance small chips.

微細部品対応キャリアテープ　Carrier tape for small chips.

特性値／ Characteristic Value

- シート幅／ Sheet width：4.0～8.0mm
- シート厚／ Sheet thickness：0.2mm
- 材質／ Material：APET, PS
- ピッチ／ Pich：0.5mm, 1.0mm, 2.0mm

特長／ Features

- チップの回転防止形状／
  Prevent Chip rotation
- 開口部R 最小化／
  Minimization opening radius (R)
- 底穴0.15φ対応可能／
  Available for center - hole (φ0.15mm)
- 棚構造対応可能／
  Shelf pocket shape


0201サイズ対応
キャリアテープ
Carrier tape for
0201 size


0201サイズ対応
キャリアテープ
（流れ方向断面写真）
Carrier Tape for 0201 Size.
(Cross-Sectional View in the
Flow Direction)


0402サイズ
狭ピッチ（0.5mm）対応
キャリアテープ
Carrier tape for 0402 size,
narrow pitch (0.5mm)


0.15φ底穴対応
キャリアテープ
Carrier tape with
φ0.15mm center -
hole


ポケット拡大図
Pocket enlarged view


棚構造対応
キャリアテープ
Carrier tape for
Shelf pocket shape


棚構造対応
キャリアテープ
（流れ方向断面写真）
Carrier tape for Shelf pocket
shape. (Cross-section photo
in the feeding direction)

シンエツ トップカバーテープ
Shin-Etsu Top Cover Tape

トップカバーテープSP21シリーズ　Top Cover Tape SP21 Series

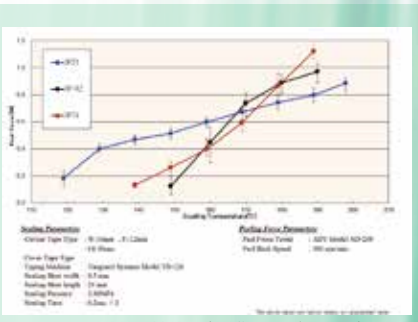
特性値／ Characteristic Value

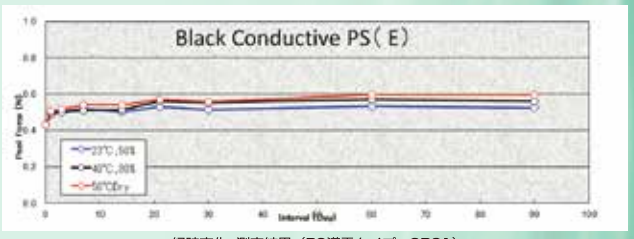
- 抵抗値／ Resistance value：7.4E+08Ω
  （PET面）（PET surface）
  （導電タイプ）（Conductive type）
  1.1E+08Ω（接着面）（Bonding surface）

特長／ Features

- 高い透明性／
  High transparency
- 剥離タイプ：層間剥離／
  Peeling Type : Interlayer Peeling
- 高速テーピング可能／
  High-speed taping available
- 温度依存性が低い／
  Low temperature dependence
- ドーミングを低減／
  Reduction of film doming


SP21リール 画像
SP21 Reel Image


シール温度性 測定結果（PS導電タイプ＊SP21）
Seal Temperature Resistance Measurement Results (PS conductive type *SP21)



経時変化 測定結果（PS導電タイプ＊SP21）
Time-dependent Change Measurement Results (PS Conductive Type *SP21)

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル3階
信越ポリマー株式会社 営業第三部 第二グループ
電話番号 03-5288-8414　FAX番号 03-5288-3113

SQ PANEL FOUP

Front Opening Unified Pod for PLP



Applications

- Front Opening Unified Pod for PLP

Features

- Panel Size :
  310 mm × 310 mm / 300 mm × 300 mm
- FOUP size :
  427 mm × 376 mm × 337 mm (H)
- Weight : 6 kg
- Mechanical Interface with load port,
  Manual open / close
- N_2 purge capability

用　途

- パネルレベルパッケージ製造プロセス用

特　長

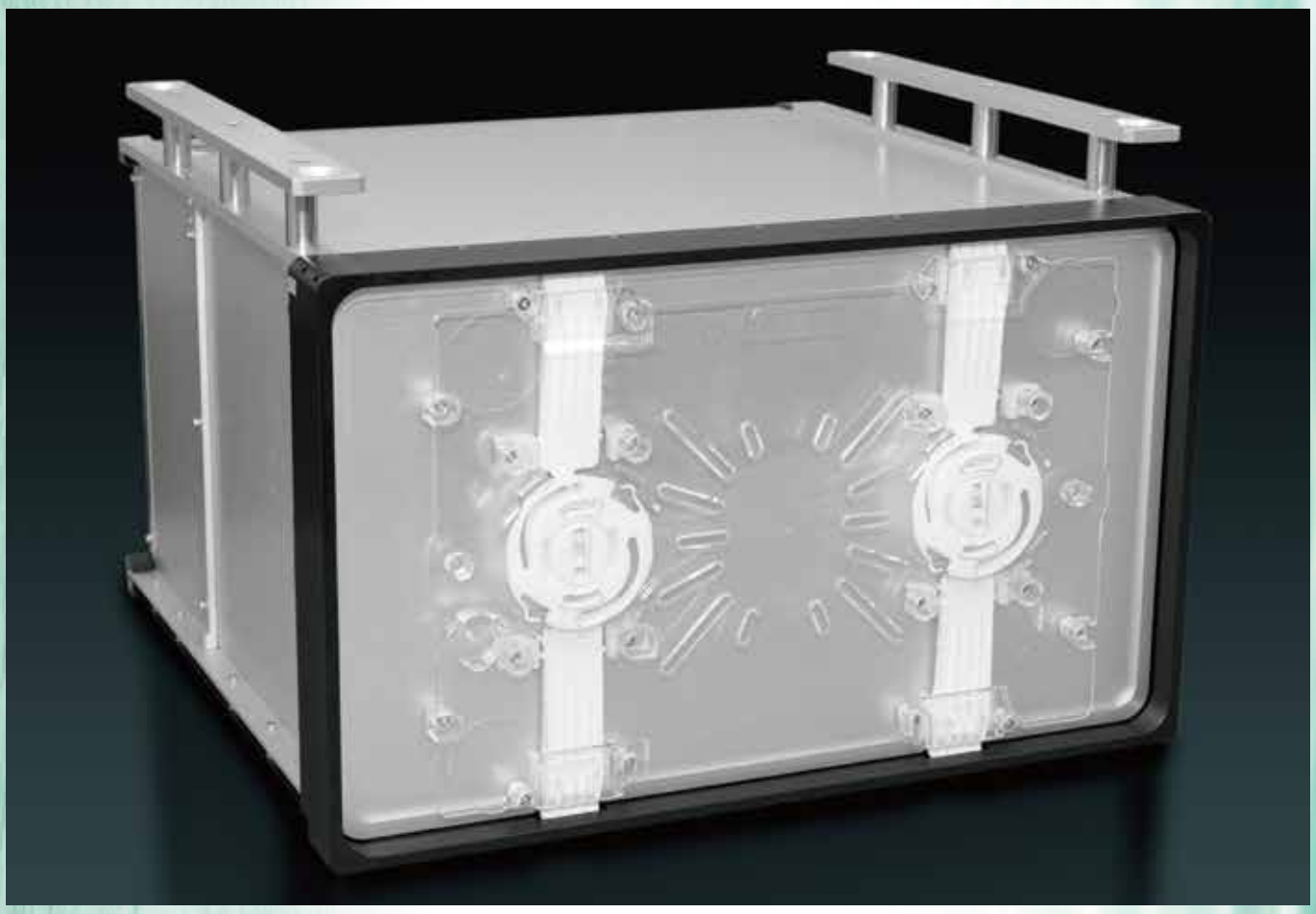
- パネルサイズ :
  310 mm × 310 mm / 300 mm × 300 mm
- サイズ :
  427 mm × 376 mm × 337 mm(高さ)
- 重量 : 6 kg
- ロードポートによるメカニカル
  インターフェイス、手動開閉可能
- N_2パージ対応可能

ShinEtsu

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル3階
信越ポリマー株式会社 営業第三部 第一グループ
電話番号 03-5288-8413　FAX番号 03-5288-3113

PANEL FOUP

Front Opening Unified Pod for PLP



Applications

- Front Opening Unified Pod for PLP

用　途

- パネルレベルパッケージ製造プロセス用

Features

- Conforms to SEMI Standard
- Panel size :
  600mm×600mm / 510mm×515mm
- 12 or 6 Slots
- FOUP size :
  740mm×703mm×437mm(H) /
  619mm×599mm×437mm(H)
- Weight : 29Kg / 26Kg
- Mechanical interfaces with load port ,
  Manual open / close
- N_2 purge capability

特　長

- SEMI規格準拠
- パネルサイズ :
  600mm×600mm / 510mm×515mm
- 12スロット / 6スロット
- サイズ :
  740mm×703mm×437mm(高さ) /
  619mm×599mm×437mm(高さ)
- 重量 : 29Kg / 26Kg
- ロードポートによるメカニカルインターフェイス、手動開閉可能
- N_2パージ対応可能

Shin-Etsu

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル3階
信越ポリマー株式会社 営業第三部 第一グループ
電話番号 03-5288-8413　FAX番号 03-5288-3113